



英特尔® 赛扬® 处理器 - 低功耗的应用计算处理器

产品主要特点

- 300 MHz 和 400 MHz:
 - 采用英特尔 0.18 微米工艺技术制成
 - 以核心频率运作的 128K 全速片上 2 级高速缓存
 - 半高型、表面安装 BGA 封装
 - BGA (31 x 27 x 2.5 毫米)、(BGA2)
 - 495 针区域阵列
 - 工作温度: 0 至 100C
- 650 MHz:
 - 采用英特尔 0.13 微米工艺技术制成
 - 以核心频率运作的 256K 全速片上 2 级高速缓存
 - 半高型、表面安装 μFCBGA 封装
 - μFCBGA 封装 (35 x 35 毫米)
 - 479 球形区域阵列
 - 工作温度: 0 至 100C
- 功能特点
 - MMX 技术
 - 浮点单元 (FPU)
 - 动态执行微体系结构
 - 具有错误检查和纠错码 (ECC) 功能的片上 2 级高速缓存
- 低功耗 400 MHz**
- 400 MHz 处理器速度
- 100 MHz 处理器侧端总线
- 10.1W TDP (最高) 6.5 W TDP (常规)
- 可以与英特尔® 815、英特尔® 815E、英特尔® 440BX AGPset 和英特尔® 440MX 芯片组一起使用
- 超低功耗 300 MHz**
- 300 MHz processor speed
- 100 MHz processor side bus
- 5.7W TDP (max), 4.2 W TDP (typ)
- 可以与英特尔 815、英特尔 815E 和英特尔 440MX 芯片组一起使用



超低电压 650 MHz

- 650 MHz 处理器速度
- 100 MHz 处理器侧端总线
- 8.3W TDP (最高), 7.0W TDP (常规)
- 可以与英特尔 440MX 和英特尔 815E 芯片组一起使用

产品介绍

英特尔® 赛扬® 处理器 - 低功耗、超低功耗和超低电压三种处理器，通过在成本、性能与低功耗之间取得最佳平衡，为温度敏感、空间受限的应用计算应用领域提供异常卓越的价值。这些处理器提供 300 和 400 MHz 的小型架构 BGA 封装（具备 128K 片上 2 级高速缓存）以及 650 MHz 的 μFCBGA 封装（具备 256K 片上 2 级高速缓存）。这些特点使之成为价值驱动型、小空间、低功率应用计算应用领域（例如数据通讯、电信、工业自动化和事务处理终端）的理想选择。

300 MHz 处理器，仅仅使用 1.1V 和 5.7 W TDP (最高)；650 MHz 处理器也只使用 1.1V 和 8.3W TDP (最高)。它们是通讯设备（例如机顶盒、网络附加存储、手持式无线上网机 (Webpad) 和其它采用低功耗架构和符合 BOM 要求的设备的理想解决方案。

产品说明

嵌入式英特尔® 架构低功耗系列处理器采用 100 MHz 处理器侧端总线，是专为实现更快的数据传输而设计，进而实现更高的性能。128K/256K 的片上 2 级高速缓存结合 0.18 和 0.13 微米制造工艺的功效为价值驱动型系统提供了卓越的低功耗处理器性能。紧凑的架构使体积减小，从而可以满足对狭小空间的需求。如此一来，可以为温度敏感和空间受限的环境提供多种价值驱动型的设计。

英特尔® 赛扬® 处理器 — 低功耗、超低功耗和超低电压

产品编号	核心速度 (MHz)	外部总线速度 (MHz)	2级 高速缓存	温控设计功率 (最大)	电压	工作温度	封装
RJ80530VY650256	650	100	256K	8.3 瓦	1.1V	0-100C	479 µFCBGA
KC80526LY400128	400	100	128K	10.1 瓦	1.35V	0-100C	495 BGA
KC80526LL300128	300	100	128K	5.7 瓦	1.1V	0-100C	495 BGA

英特尔联系信息

开发商网站

developer.intel.com

嵌入式英特尔® 架构主页

developer.intel.com/design/intarch

其它英特尔支持：
英特尔文献中心

developer.intel.com/design/litcentr
(800) 548-4725, 美国中央时间早上 7 点至晚上 7 点
(美国和加拿大)

如您在其它国家或地区，请联系您的本地销售办事处。

综合信息热线

(800) 628-8686 或 (916) 356-3104, 太平洋标准时间早上 5 点
至下午 5 点

本文档所提供的信息全部关于英特尔产品。本文档不通过不容反证或其它方式，明示或暗示地授予知识产权许可。除在英特尔产品销售条款及条件中规定的责任外，英特尔不再负有其它责任，也不对与英特尔产品销售及使用相关的任何明示或暗示的担保负责，包括对特定用途的适用性、可销售性或侵犯任何专利权、版权或知识产权的责任或担保。英特尔产品并不适用于医疗、生命救援或生命延续。英特尔可随时更改产品规格与说明，恕不另行通知。

设计人员不能以无标注或标有“保留”或“未定义”等字样的功能或指导为依据。英特尔将保留这些供以后进行定义，并对这些作出的未来更改可能导致的冲突或不符之处一律不承担任何责任。

英特尔、英特尔徽标和赛扬是英特尔公司和其子公司在美国及其它国家(或地区)的商标或注册商标。

*其它名称和品牌为各自拥有者所有。



要获取更多信息，请访问英特尔网站：developer.intel.com

美国和加拿大

Intel Corporation
Robert Noyce Bldg.
2200 Mission College Blvd.
P.O. Box 58119
Santa Clara, CA 95052-8119
USA

欧洲

Intel Corporation (UK) Ltd.
Pipers Way
Swindon
Wiltshire SN3 1RJ
UK

亚太地区

Intel Semiconductor Ltd.
32/F Two Pacific Place
88 Queensway, Central
Hong Kong, SAR

日本

Intel Kabushiki Kaisha
P.O. Box 115 Tsukuba-gakuen
5-6 Tokodai, Tsukuba-shi
Ibaraki-ken 305
Japan

南美

Intel Semiconductores do Brazil
Rue Florida, 1703-2 and CJ22
CEP 04565-001 Sao Paulo-SP
Brazil